

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 4 月 12 日(12.04.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/046809 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 65/02 (2006.01) C08L 25/04 (2006.01)
B65D 73/02 (2006.01) C08L 51/04 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01) C08L 53/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/073112
- (22) 国際出願日: 2011 年 10 月 6 日(06.10.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-227462 2010 年 10 月 7 日(07.10.2010) JP
特願 2010-286980 2010 年 12 月 24 日(24.12.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤原 純平 (FUJIWARA Junpei) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 川田 正寿(KAWATA Masatoshi) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外(SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: STYRENE RESIN COMPOSITION, AND MOLDED ARTICLE THEREOF

(54) 発明の名称: スチレン系樹脂組成物及びその成形体

(57) Abstract: Provided are a styrene resin composition for use in electronic component packaging such as embossed carrier tape, a sheet which has a large drawing ratio (pocket depth) and in which pockets exhibiting superior transparency and strength and can be thermoformed, and a carrier tape which is thermoformed from the sheet and which allows the verification of letters and the like formed on packaged electronic components from outside the pockets. The electronic component packaging sheet comprises: (A) 29-65 mass parts of a styrene-conjugated diene block copolymer; (B) 51-15 mass parts of a polystyrene resin; and (C) 20-9 mass parts of an impact resistant polystyrene resin. Components (A)-(C) each have a weight average molecular weight (Mw) within a specified range.

(57) 要約: エンボスキャリアテープ等の電子部品包装に用いるスチレン系樹脂シートであって、熱成形によって絞り比(ポケット深さ)が大きくて、透明性及び強度に優れたポケットを形成することが可能であるシート、およびそのシートを熱成形して、ポケットの外から収納電子部品に記載された文字等を確認できるキャリアテープ等を提供する。(A) スチレン-共役ジエンブロック共重合体が29~65質量部、(B) ポリスチレン樹脂が51~15質量部、及び(C) 耐衝撃性ポリスチレン樹脂が20~9質量部を含んでなり、(A)~(C)成分がそれぞれ特定の範囲の重量平均分子量(Mw)を有する電子部品包装用シート。



WO 2012/046809 A1